

2014年度第2四半期 決算説明会

2014年10月31日
株式会社村田製作所



- 当第2四半期の売上高は四半期ベースで過去最高を記録。スマートフォン、タブレット端末や自動車向けなど、幅広い製品で需要が大きく拡大
- 第2四半期の営業利益は四半期ベースでの過去最高を更新。営業利益率は20%に上昇
- 上期の業績予想に対する営業利益の達成率は125%。これを受けて通期の業績予想を上方修正し、当期純利益で14年ぶりに過去最高の更新を見込む

1. 2014年度 第2四半期業績概要

2014年7月～2014年9月
第2四半期連結会計期間

業績概況

| | 2013年度 | | 2014年度 | | | | | | 直前四半期比 | | 前年同期比 | |
|---------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| | 上半期 | | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 上半期 | | 14Q2/14Q1 | | 14年上期/13年上期 | |
| | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| 売上高 | 4,141 | 100.0 | 2,180 | 100.0 | 2,586 | 100.0 | 4,766 | 100.0 | +406 | +18.6 | +625 | +15.1 |
| 営業利益 | 674 | 16.3 | 369 | 16.9 | 523 | 20.2 | 891 | 18.7 | +154 | +41.6 | +217 | +32.2 |
| 税引前四半期純利益 | 683 | 16.5 | 372 | 17.1 | 582 | 22.5 | 953 | 20.0 | +210 | +56.4 | +270 | +39.5 |
| 当社株主に帰属する 四半期純利益 | 476 | 11.5 | 269 | 12.4 | 416 | 16.1 | 685 | 14.4 | +147 | +54.4 | +209 | +43.8 |

製品別売上高

| | 2013年度 | | 2014年度 | | | | 直前四半期比 | | 前年同期比 | |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| | 上半期 | | 第1四半期 | 第2四半期 | 上半期 | | 14Q2/14Q1 | | 14年上期/13年上期 | |
| | (億円) | (%) | (億円) | (億円) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| コンデンサ | 1,384 | 33.5 | 698 | 834 | 1,531 | 32.2 | +136 | +19.5 | +147 | +10.6 |
| 圧電製品 | 485 | 11.8 | 286 | 306 | 592 | 12.5 | +21 | +7.2 | +107 | +21.9 |
| その他コンポーネント | 783 | 19.0 | 466 | 565 | 1,031 | 21.7 | +100 | +21.4 | +248 | +31.7 |
| 通信モジュール | 1,197 | 29.0 | 585 | 741 | 1,325 | 27.9 | +156 | +26.7 | +128 | +10.7 |
| 電源他モジュール | 278 | 6.7 | 138 | 131 | 269 | 5.7 | ▲6 | ▲4.5 | ▲9 | ▲3.2 |
| 製品売上高計 | 4,128 | 100.0 | 2,171 | 2,578 | 4,749 | 100.0 | +407 | +18.7 | +621 | +15.0 |

(注) 東光(株)の売上高は2014年度連結累計期間より「その他コンポーネント」に含んでおります

製品別売上高概況

[2013年度上半期→2014年度上半期]

| | |
|--|--|
| <p>コンデンサ (前年同期比+10.6%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ チップ積層セラミックコンデンサ (MLCC) 主に携帯電話、カーエレクトロニクス向けで大きく伸長 |
| <p>圧電商品 (前年同期比+21.9%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 表面波フィルタ 中国のスマートフォン需要の拡大およびLTE端末へのシフトにより大幅に増加 ○ 圧電センサ ショックセンサがHDD向けで伸長 |
| <p>その他コンポーネント (前年同期比+31.7%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ コイル 高周波チップコイルがスマートフォン向けで増加したほか、連結子会社化した東光（株）のコイル関連製品が加わったことで大幅に伸長 ○ EMI 除去フィルタ カーエレクトロニクス向けや通信向けで好調 ○ コネクタ スマートフォン向けを中心に増加 ○ センサ MEMSセンサがカーエレクトロニクス向けで大きく増加 |
| <p>通信モジュール (前年同期比+10.7%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 近距離無線通信モジュール スマートフォン、タブレット端末向けが大幅に増加 ○ 通信機器用モジュール 新製品の投入効果もあり、スマートフォン向けが飛躍的に増加 |
| <p>電源他モジュール (前年同期比▲3.2%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▲ 電源 カーオーディオ向けで振るわず |

製品別売上高概況

[2014年度第1四半期→2014年度第2四半期]

| | |
|------------------------------|---|
| コンデンサ (直近四半期比+19.5%) | ○ チップ積層セラミックコンデンサ (MLCC) 小型品、大容量品が通信機器、ゲーム機、カーエレクトロニクスなど幅広い用途向けで大幅に増加 |
| 圧電商品 (直近四半期比+7.2%) | ○ 表面波フィルタ スマートフォン向けで需要の拡大により好調に推移 ○ 圧電センサ ショックセンサ、アクチュエータがHDD向けに増加 |
| その他コンポーネント (直近四半期比+21.4%) | ○ コイル 主にスマートフォン向けに大幅に増加 ○ EMI除去フィルタ、コネクタ スマートフォン、タブレット端末向けに大きく伸長 |
| 通信モジュール (直近四半期比+26.7%) | ○ 近距離無線通信モジュール スマートフォン、タブレット端末向けに飛躍的に増加 ○ 通信機器用モジュール 新製品の投入効果もあり、スマートフォン向けで大幅に増加 |
| 電源他モジュール (直近四半期比▲4.5%) | ▲ 電源 O A機器向けが増加したものの、アミューズメント向けが減少 |

用途別売上高

| | 2013年度 | | 2014年度 | | | | 直前四半期比 | | 前年同期比 | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| | 上半期 | | 第1四半期 | 第2四半期 | 上半期 | | 14Q2/14Q1 | | 14年上期/13年上期 | |
| | (億円) | (%) | (億円) | (億円) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| A V | 235 | 5.7 | 116 | 141 | 257 | 5.4 | +25 | +21.1 | +21 | +9.0 |
| 通信 | 2,103 | 50.9 | 1,042 | 1,361 | 2,403 | 50.6 | +318 | +30.5 | +300 | +14.3 |
| コンピュータ及び関連機器 | 716 | 17.4 | 391 | 436 | 828 | 17.4 | +45 | +11.6 | +111 | +15.6 |
| カーエレクトロニクス | 578 | 14.0 | 337 | 357 | 694 | 14.6 | +20 | +6.0 | +116 | +20.1 |
| 家電・その他 | 496 | 12.0 | 284 | 283 | 567 | 12.0 | ▲2 | ▲0.5 | +72 | +14.4 |
| 製品売上高計 | 4,128 | 100.0 | 2,171 | 2,578 | 4,749 | 100.0 | +407 | +18.7 | +621 | +15.0 |

(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高概況

[2013年度上半期→2014年度上半期]

| | |
|-------------------------------|--|
| AV (前年同期比+9.0%) | ○ゲーム機向け、薄型TV向けで大容量コンデンサが増加 |
| 通信 (前年同期比+14.3%) | ○スマートフォン向けでLTE端末の生産増加により、近距離通信モジュール、通信機器用モジュール、小型・大容量コンデンサが大幅に増加 ○中国におけるLTE端末へのアップシフトにより、表面波フィルタ、高周波チップコイル、多層デバイスなどが大きく伸長 |
| コンピュータ及び関連機器 (前年同期比+15.6%) | ○タブレット端末向けで近距離無線通信モジュールやMLCC、コネクタが大幅に増加 ○HDD向けでショックセンサが伸長 |
| カーエレクトロニクス (前年同期比+20.1%) | ○車の電装化の進展により、車載用MLCC、EMI除去フィルタが大きく増加 ○安全装置向けでMEMSセンサが大幅に増加 |

(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高概況

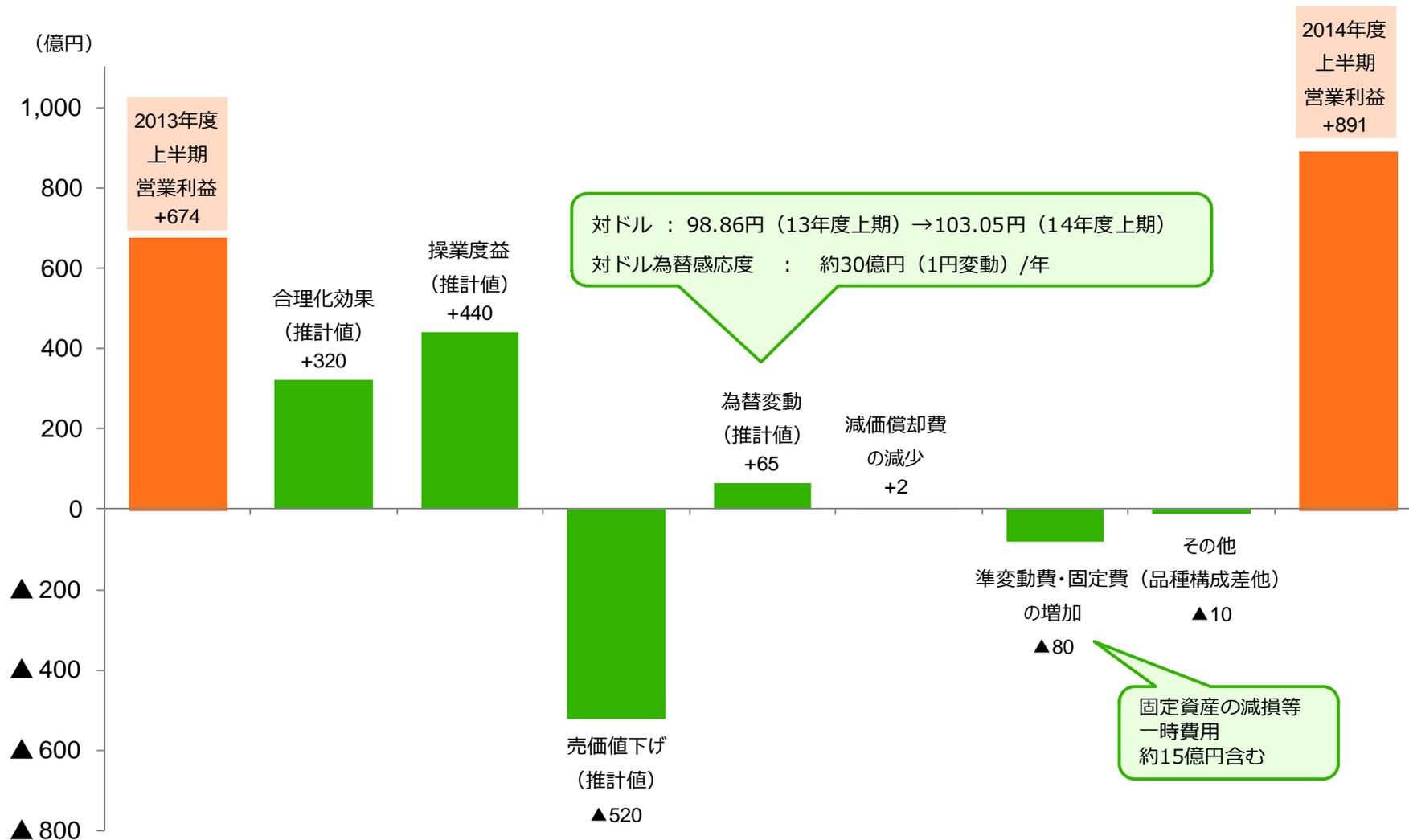
[2014年度第1四半期→2014年度第2四半期]

| | |
|--|---|
| <p>AV (直近四半期比+21.1%)</p> | <ul style="list-style-type: none">○ゲーム機向けや薄型TV向けに大容量コンデンサが大幅に増加○デジタルカメラ向けに近距離無線通信モジュールが増加 |
| <p>通信 (直近四半期比+30.5%)</p> | <ul style="list-style-type: none">○スマートフォンの新モデル向けにより、近距離無線通信モジュール、通信機器用モジュール、小型・大容量コンデンサ、コネクタ、高周波チップコイルなど幅広い製品で大きく伸長 |
| <p>コンピュータ及び関連機器 (直近四半期比+11.6%)</p> | <ul style="list-style-type: none">○タブレット端末向けで近距離無線通信モジュール、コネクタ、コンデンサなどが大きく増加○ノートPC向けで通信機器用モジュール、コンデンサが増加○HDD向けでショックセンサ、アクチュエータが好調 |
| <p>カーエレクトロニクス (直近四半期比+6.0%)</p> | <ul style="list-style-type: none">○電装化の進展で車載用MLCC、EMI除去フィルタが好調○安全装置向けで超音波センサが増加 |

(注) 当社推計値に基づいております

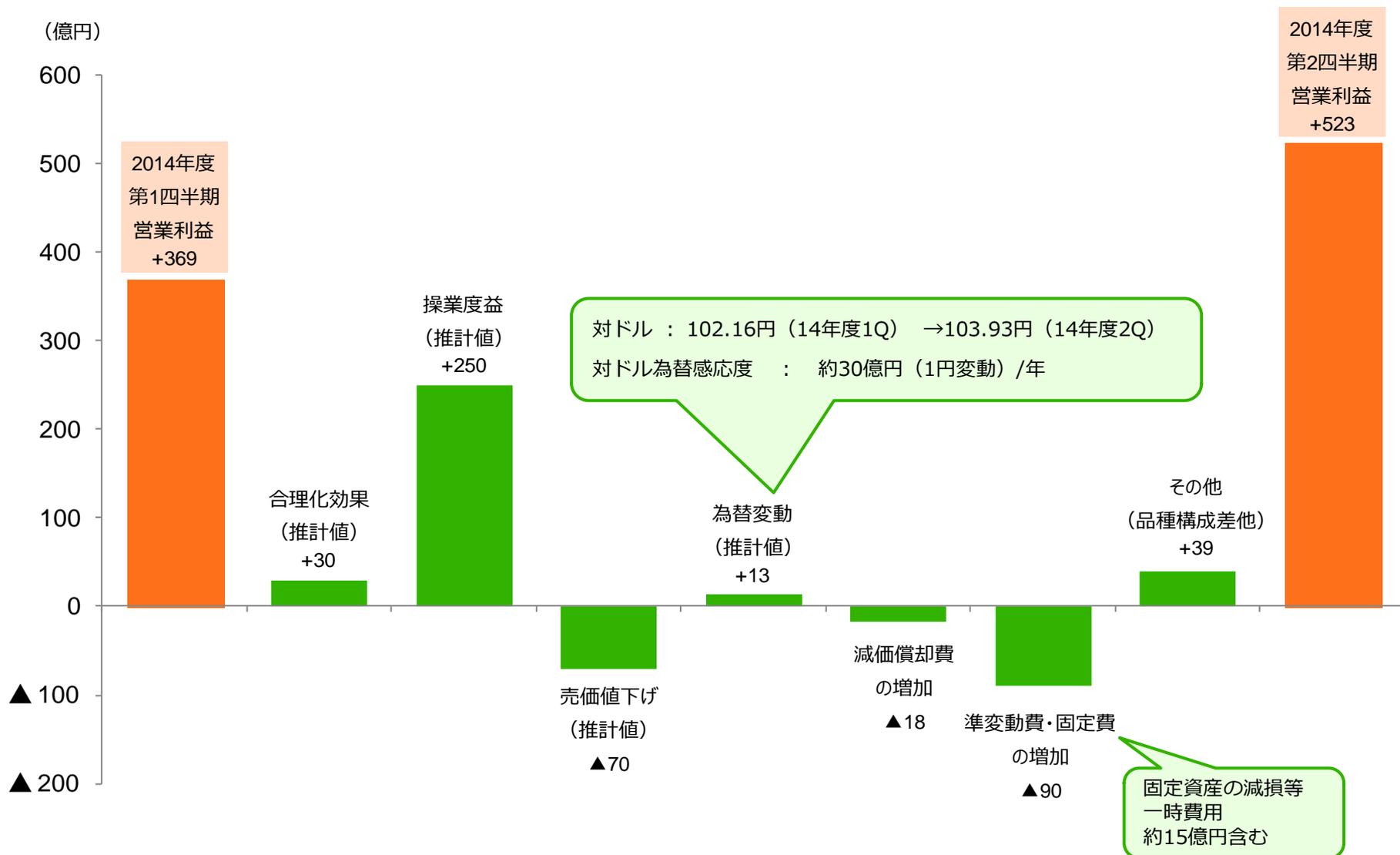
利益変動要因

[2013年度上半期→2014年度上半期]

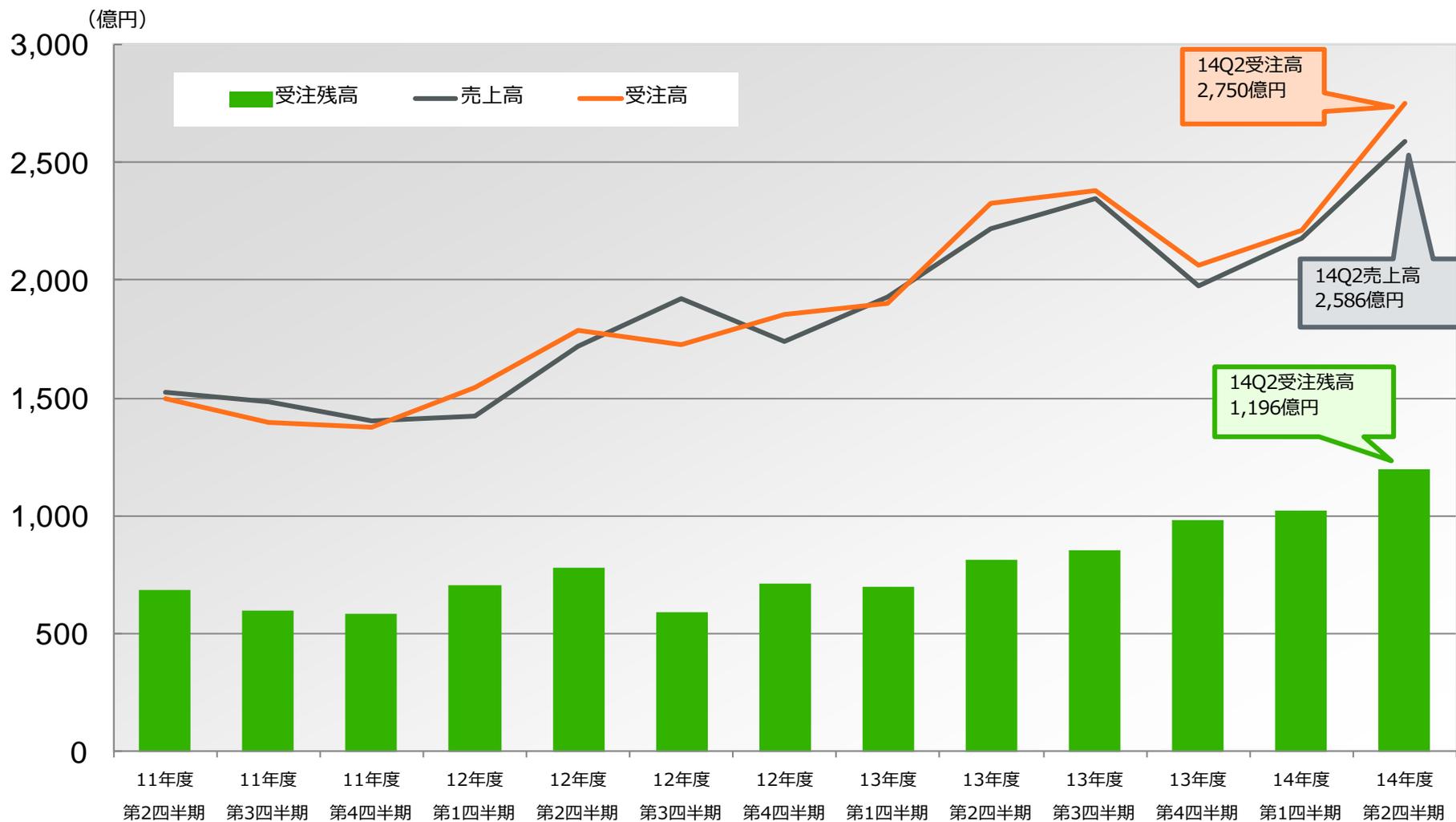


利益変動要因

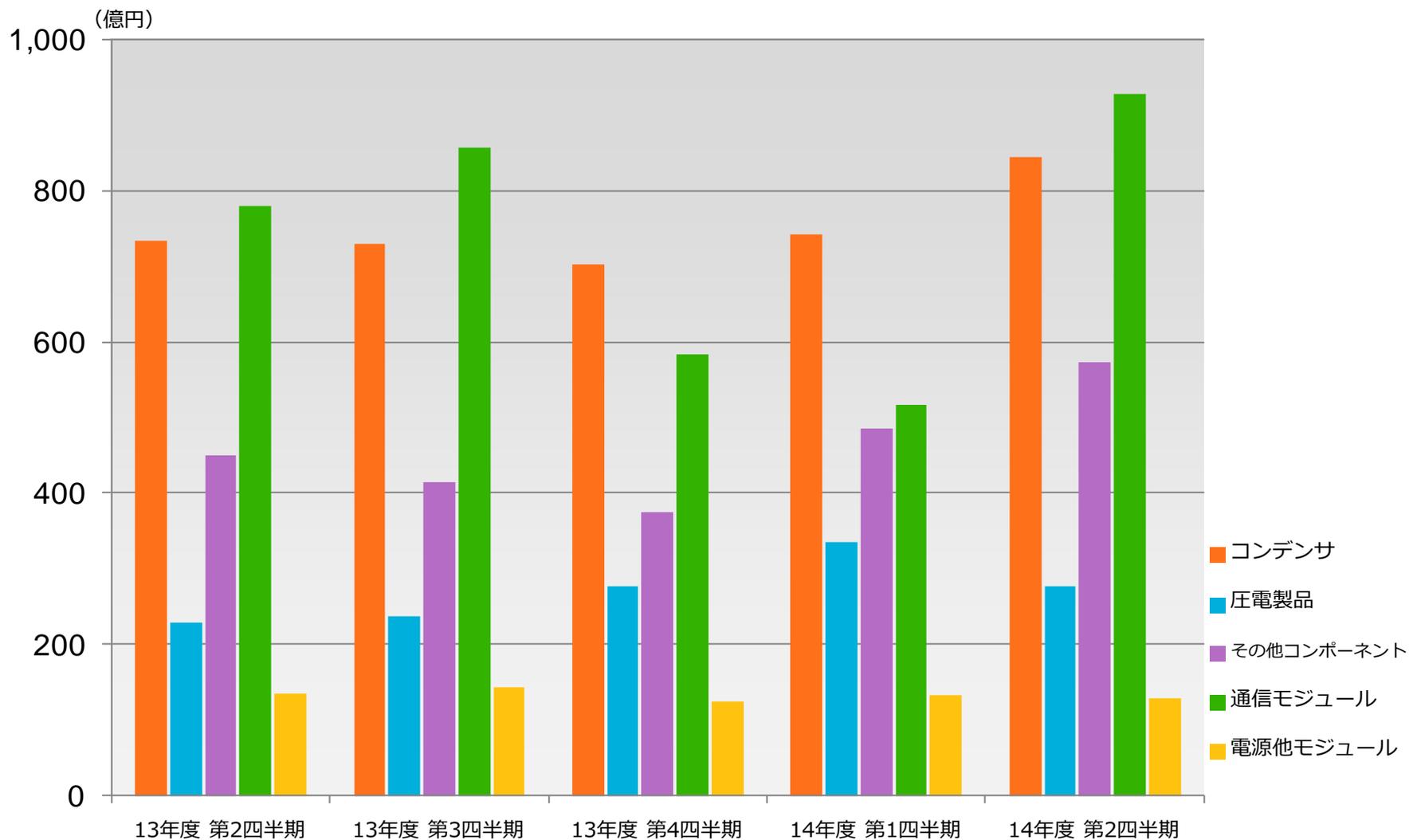
[2014年度第1四半期→2014年度第2四半期]



売上・受注・注残推移（四半期）



製品別受注高推移



(注) 東光(株)の受注高は2014年度連結累計期間より「その他コンポーネント」に含んでおります

2. 2014年度 業績予想 (2014年4月～2015年3月)

部品需要予測（通期／通信）

| | 2013年度 | | 2014年度予想 | | |
|----------------|----------------|---|----------------|-------------|--|
| 携帯電話 合計 | 17.0 億台 | → | 18.1 億台 | +6% |  |
| 2G | 5.4 億台 | → | 4.4 億台 | ▲19% |  |
| 3G | 8.4 億台 | → | 8.4 億台 | 横這い |  |
| LTE | 3.2 億台 | → | 5.3 億台 | +65% |  |
| スマートフォン | 10.6 億台 | → | 13.2 億台 | +25% |  |

部品需要予測（通期／PC及び関連機器、AV）

2013年度

2014年度予想

| PC | 5.1 億台 | → | 5.2 億台 | + 1% |  |
|--------|--------|---|--------|--------|---|
| デスクトップ | 1.4 億台 | → | 1.3 億台 | 0%~▲5% |  |
| ノートブック | 1.7 億台 | → | 1.7 億台 | 0%~▲5% |  |
| タブレット | 2.0 億台 | → | 2.2 億台 | + 10% |  |
| 薄型TV | 2.1 億台 | → | 2.1 億台 | 横這い |  |

部品需要予測（半期／通信）

2014年度上期

2014年度下期予想

| 携帯電話 合計 | 9.3 億台 | → | 8.8 億台 | ▲6% |  |
|---------|--------|---|--------|------|--|
| 2G | 2.3 億台 | → | 2.1 億台 | ▲8% |  |
| 3G | 4.4 億台 | → | 3.9 億台 | ▲12% |  |
| LTE | 2.5 億台 | → | 2.8 億台 | +7% |  |
| スマートフォン | 6.7 億台 | → | 6.5 億台 | ▲2% |  |

部品需要予測（半期／PC及び関連機器、AV）

2014年度上期

2014年度下期予想

| | 2014年度上期 | → | 2014年度下期予想 | | |
|-------------|---------------|---|---------------|---------------|---|
| PC | 2.7 億台 | | 2.6 億台 | 0%~▲5% |  |
| デスクトップ | 0.7 億台 | → | 0.7 億台 | 0%~▲5% |  |
| ノートブック | 0.9 億台 | → | 0.8 億台 | 0%~▲5% |  |
| タブレット | 1.1 億台 | → | 1.2 億台 | +7% |  |
| 薄型TV | 1.1 億台 | → | 1.0 億台 | ▲8% |  |

製品別売上予想

| | 2014年度 通期予想 (前年度比) | 2014年度 下期予想 (上期比) |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| コンデンサ | + 10% | 横這い |
| 圧電製品 | + 15% | ▲ 15%程度 |
| その他コンポーネント | + 30% | + 3%程度 |
| 通信モジュール | + 8% | + 12%程度 |
| 電源他モジュール | + 5% | + 10%程度 |
| 製品売上高計 | + 14% | + 3%程度 |

用途別売上予想

| | 2014年度 通期予想 (前年度比) | 2014年度 下期予想 (上期比) |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| A V | + 12% | ▲5%程度 |
| 通信 | + 14% | + 4%程度 |
| コンピュータ及び関連機器 | + 11% | + 3%程度 |
| カーエレクトロニクス | + 17% | + 2%程度 |
| 家電・その他 | + 15% | 横這い |
| 製品売上高計 | + 14% | + 3%程度 |

(注) 当社推計値に基づいております

2014年度 業績予想

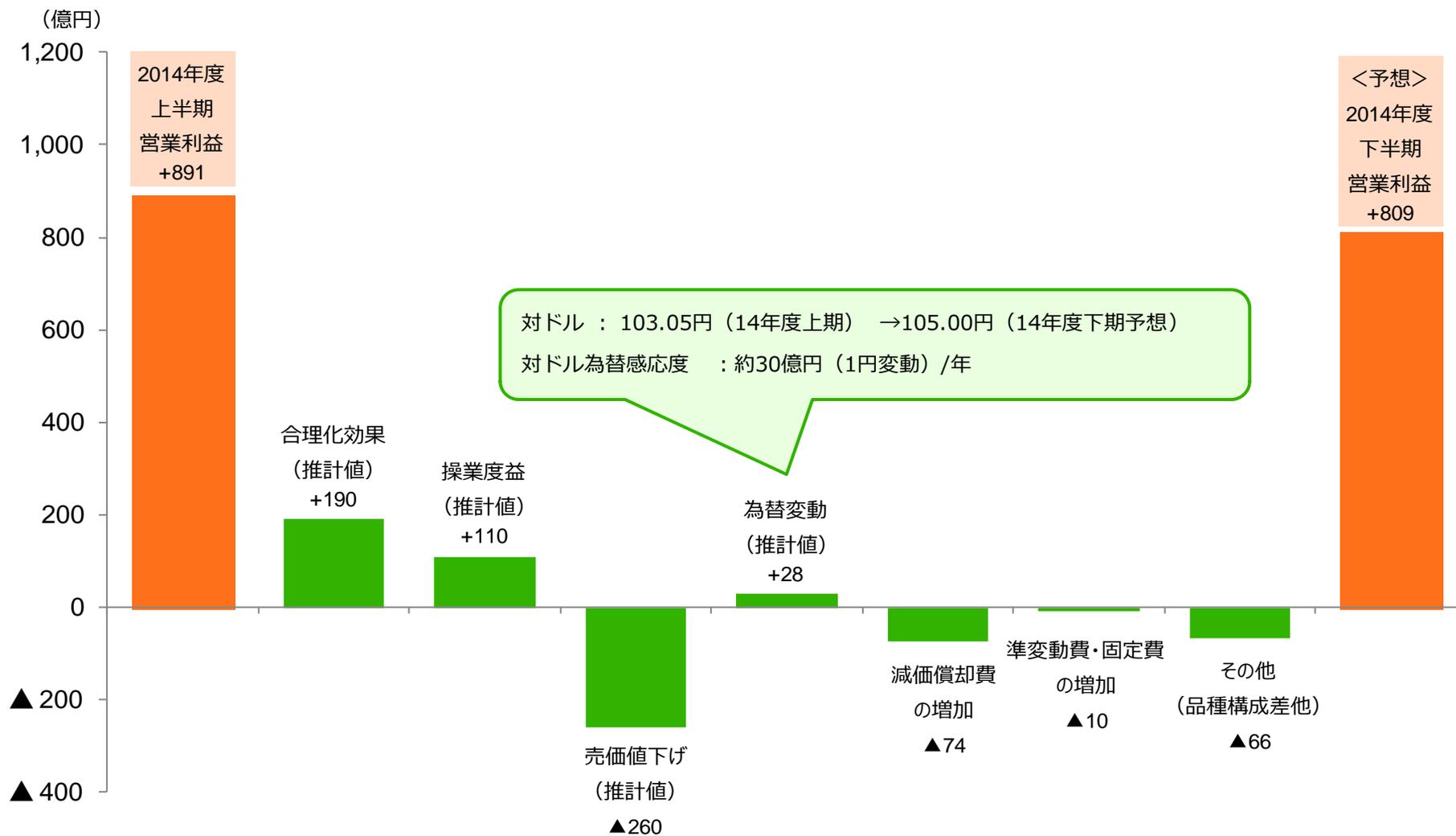
| | 前回予想（14年4月） | | | 今回予想 | | | | | |
|---------------------|-------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| | 上期予想 | 下期予想 | 2014年度 通期予想 | 上期実績 | | 下期予想 | | 2014年度 通期予想 | |
| | | | | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| 売上高 | 4,450 | 4,750 | 9,200 | 4,766 | 100.0 | 4,884 | 100.0 | 9,650 | 100.0 |
| 営業利益 | 710 | 730 | 1,440 | 891 | 18.7 | 809 | 16.6 | 1,700 | 17.6 |
| 税引前四半期純利益 | 730 | 750 | 1,480 | 953 | 20.0 | 797 | 16.3 | 1,750 | 18.1 |
| 当社株主に帰属する 四半期純利益 | 510 | 510 | 1,020 | 685 | 14.4 | 556 | 11.4 | 1,240 | 12.8 |

業績予想の前提

| | 2014年度 上期実績 | 2014年度 下期予想 | 2014年度 通期予想 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 減価償却費 | 383 億円 | 457 億円 | 840 億円 |
| 研究開発費 | 296 億円 | 324 億円 | 620 億円 |
| 設備投資額 | 447 億円 | 353 億円 | 800 億円 |
| 為替レート(US\$) | 103.05 円/US\$ | 105.00 円/US\$ | |
| 為替レート(EUR) | 138.91 円/EUR | 135.00 円/EUR | |

利益変動要因

[2014年度上半期→2014年度下半期予想]

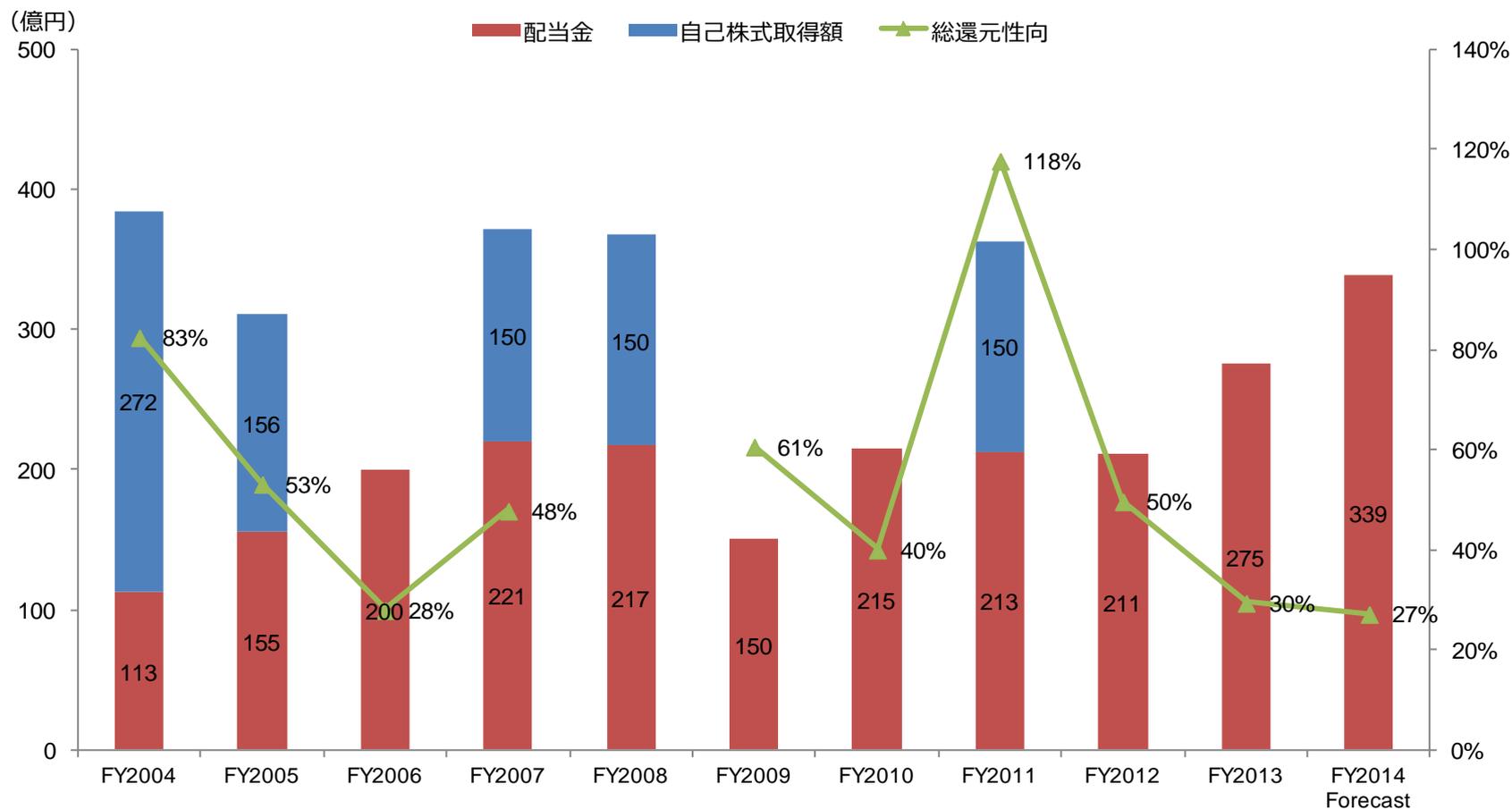


2014年度（2015年3月期）の配当（予定）
1株当たり年間160円
（中間配当80円／期末配当80円）

2013年度の配当実績
1株当たり年間130円
（中間配当60円／期末配当70円）

※当配当は現時点での事業環境予測及び業績予想に基づくものであります

株主還元推移



利益還元策としては、配当による配分を優先的に考え、1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めます

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

Thank you

